



# 产品认证证书

证书编号: CQC23001405541

发证日期: 2023年09月21日  
有效期至: 2028年09月20日

委托人名称	Fairchild Semiconductor Pte Ltd
及注册地址	10 Ang Mo Kio Street 65, #03-06/08 TECHPOINT 新加坡
制造商名称	Fairchild Semiconductor Pte Ltd
及注册地址	10 Ang Mo Kio Street 65, #03-06/08 TECHPOINT 新加坡
生产企业名称	Liteon Electronics (Thailand) Co Ltd
及生产地址	38/4 Moo 1, Rangsit Ongkarak Road, Bunyeetoh Tanyaburi Patthumthani 12130 ,Thailand
产品名称和系列、 规格、型号	光电耦合器 见附件(加强绝缘,绝缘穿透距离 $\geq 0.4\text{mm}$ ,外部爬电距离 $\geq 8.0\text{mm}$ ,通过110°C热循环测试,仅适用于海拔5000米及以下)
产品标准和技术要求	GB 4943.1-2022
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求,特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC23001405541

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

H11L1\*M、H11L2\*M、H11L3\*M、4N25\*M、4N26\*M、4N27\*M、4N28\*M、4N32\*M、4N33\*M、4N35\*M、4N36\*M、4N37\*M、4N38\*M、CNY171\*M、CNY172\*M、CNY173\*M、CNY174\*M、CNY17F1\*M、H11A1\*M、H11AV1A\*M、H11AV1\*M、H11B1\*M、H11D1\*M、H11F1\*M、H11F3\*M、H11G1\*M、H11G2\*M、MCT2E\*M、MCT5210\*M、MCT5211\*M、MOC8050\*M、MOC8106\*M、TIL111\*M、TIL113\*M、TIL117\*M、MOC3010\*M、MOC3011\*M、MOC3012\*M、MOC3020\*M、MOC3021\*M、MOC3022\*M、MOC3023\*M、MOC3031\*M、MOC3032\*M、MOC3033\*M、MOC3041\*M、MOC3042\*M、MOC3043\*M、MOC3051\*M、MOC3052\*M、MOC3061\*M、MOC3062\*M、MOC3063\*M、MOC3081\*M、MOC3082\*M、MOC3083\*M、MOC3162\*M、MOC3163\*M、H11AA1\*M、H11AA4\*M

(注：\*可以是空白或者以下数字和/或字母的组合，意义是：

空白：表示产品为双列直插式封装形式

S：表示产品为表面安装封装形式；

SR2：表示产品为表面安装封装形式，卷盘包装；

T：表示产品为宽引线间距封装形式；

V：表示产品已经通过 VDE 认证；

TV：表示产品已经通过 VDE 认证，宽引线间距封装形式；

SV：表示产品已经通过 VDE 认证，表面安装封装形式；

SR2V：表示产品已经通过 VDE 认证，表面安装封装形式，卷盘包装；

TS：表示产品为表面安装封装形式 TS；

TSD：表示产品为表面安装封装形式 TS，卷盘包装；

TSDV：表示产品已经通过 VDE 认证，表面安装封装形式 TS，卷盘包装)



## 中国质量认证中心